

TO2.5G、10G共晶设备

外观和主要功能获专利保护



创新点：

技术一；芯片拾取焊接系统
技术二；高精度芯片快速定位装置
技术三；蓝膜分离取晶装置
技术四；产品夹取90°翻转共晶装置

技术指示：

直线电机； X、Y、重复精度5um、R1°
品种兼容性; TO3.8 / TO5.6
共晶焊台； 常温—400度、90°翻转焊接
UPH 值； 550 / PCS

品质精度： $\leq + -10\mu\text{M}$,角度 $+ -1^\circ$

主件 移动： 光标定位 \ 线性电机

芯片定位; 重心检测 \ 图像识别

运行软件; 模块化控制 / 惯量定位

知识产权： 发明5项、外观1项、实用新型17项、
软件著作权1项

焊接示意图：

- 1 → 底座
- 2 → 热沉
- 3 → 芯片



创新点：

技术一；芯片拾取焊接系统
技术二；高精度芯片快速定位装置
技术三；蓝膜分离取晶装置
技术四；产品夹取90°翻转共晶装置

技术指示：

直线电机； X、Y、重复精度5um、R1°
品种兼容性; TO3.8 / TO5.6
共晶焊台； 常温—400度、90°翻转焊接
UPH 值； 550 / PCS

品质精度： $\leq + -10\mu\text{M}$,角度 $+ -1^\circ$

主件 移动： 光标定位 \ 线性电机

芯片定位; 重心检测 \ 图像识别

运行软件; 模块化控制 / 惯量定位

知识产权： 发明5项、外观1项、实用新型17项、
软件著作权1

软件著作权1